

## 積體電路業產值連續四年創新高

- 積體電路產值可望續創新高：**近年來行動裝置推陳出新，帶動高階製程技術之需求大增，致 102 年起我國積體電路業產值連年創下歷史新高，102、103 年各呈二位數成長，分別年增 16.2% 及 23.9%。惟 104 年下半年至 105 年上半年因全球經濟疲弱，手持行動裝置銷售滯緩，致 104 年產值僅年增 6.2%，105 年下半年因終端電子產品需求回升，加上物聯網、車用電子、智慧自動化等新興應用發展，致 105 年 1 至 10 月產值達 1 兆 392 億元，年增 5.4%，預期 105 年全年積體電路業產值將突破 1 兆 2 千億元，續創新高。
- 晶圓代工為積體電路業成長之主力：**按產品觀察，晶圓代工產值占積體電路八成以上，由於我國先進製程技術持續精進，國際各大品牌行動裝置推陳出新，通訊晶片需求強勁，累計 105 年 1 至 10 月產值達 9,035 億元(年增 8.6%)，為積體電路業成長之最主要貢獻來源；DRAM 產值居次，因價格相對較 104 年為低而年減 12.5%。
- 積體電路出口市場以中國大陸及香港居冠：**我國積體電路業直接外銷比率約八成，105 年 1 至 11 月積體電路出口總值達 709 億美元，較 104 年同期成長 11.1%，主要出口市場以中國大陸及香港(占 54.8%)為首，年增 22.5% 最為顯著；新加坡(占 14.1%)居次，年減 6.5%，日本(占 8.7%)及南韓(占 8.5%)再次之。
- 國內業者為保持領先優勢提高資本支出：**為提升競爭優勢，國內業者積極進行研發及投資，尤以晶圓代工廠投入資本支出最為可觀。依據證交所公開資訊觀測站公布之 105 年前 3 季資料顯示，台積電資本支出 2,155 億元(年增 24.6%)，聯電 697 億元(年增 47.7%)，有助於推升積體電路業之生產能量。
- 我國晶圓代工市占穩居全球第一：**根據國際研調機構顧能(Gartner)統計，104 年全球晶圓代工銷售市場為 489 億美元，其中台積電市占率高達 54.3%，較 103 年增加 0.5 個百分點，穩居全球晶圓代工市場之第一名寶座，聯電、力晶科技、世界先進等亦名列全球晶圓代工前十大廠商，市占率合占 67.2%，與 103 年相近。

我國積體電路業產值統計



表1 我國積體電路業產品產值統計

單位：億元

業別及主要產品	100年	101年	102年	103年	104年	105年	年增率%
						1-10月	
<b>積體電路業</b>	<b>7,070</b>	<b>7,653</b>	<b>8,892</b>	<b>11,021</b>	<b>11,701</b>	<b>10,392</b>	<b>5.4</b>
晶圓代工	5,456	6,375	7,411	9,073	9,900	9,035	8.6
DRAM	1,069	827	1,155	1,562	1,365	1,021	-12.5
IC製造(不含DRAM)	420	385	397	386	383	336	5.2

資料來源：經濟部統計處。

表2 我國積體電路出口總值-按出口地區分

單位：百萬美元

出口地區	100年	101年	102年	103年	104年	105年 1-11月
<b>出口總值</b>	<b>55,528</b>	<b>57,886</b>	<b>62,823</b>	<b>72,297</b>	<b>69,429</b>	<b>70,924</b>
中國大陸及香港	28,350	29,156	32,066	37,764	34,684	38,831
新加坡	10,340	11,353	11,773	13,174	11,550	9,996
日本	3,484	3,814	4,643	5,007	6,438	6,158
南韓	5,585	6,008	6,119	6,681	7,297	6,058
<b>年增率(%)</b>	<b>10.6</b>	<b>4.2</b>	<b>8.5</b>	<b>15.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>11.1</b>
中國大陸及香港	8.3	2.8	10.0	17.8	-8.2	22.5
新加坡	50.2	9.8	3.7	11.9	-12.3	-6.5
日本	-37.1	9.5	21.7	7.8	28.6	4.1
南韓	30.5	7.6	1.8	9.2	9.2	-11.1
<b>占比(%)</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
中國大陸及香港	51.1	50.4	51.0	52.2	50.0	54.8
新加坡	18.6	19.6	18.7	18.2	16.6	14.1
日本	6.3	6.6	7.4	6.9	9.3	8.7
南韓	10.1	10.4	9.7	9.2	10.5	8.5

資料來源：財政部關務署。

附註：1. 積體電路出口係以海關稅則號別8542節項下之商品出口總值。

2. 自我國出口積體電路(HS 8542)中，除含我國生產之積體電路外，尚包括進口加工品及封裝測試等價值，計算範圍與表1不同。

表3 國內主要晶圓代工公司資本支出概況

單位：億元

統計項目	102年	103年	104年	105年 1-9月	年增率%
台積電	2,876	2,885	2,575	2,155	24.6
聯電	329	432	605	697	47.7

資料來源：臺灣證券交易所公開資訊觀測站。

表4 104年全球前十大晶圓代工廠

排名		公司名稱	年營收(億美元)		市占率(%)	
104年	103年		104年	103年	104年	103年
1	1	TSMC(台積電)	265.7	251.8	54.3	53.8
2	3	Globalfoundries	46.7	44.0	9.6	9.4
3	2	UMC(聯華電子)	45.6	46.2	9.3	9.9
4	4	Samsung Electronics	26.1	24.1	5.3	5.2
5	5	SMIC	22.3	19.7	4.6	4.2
6	6	Powerchip(力晶科技)	9.9	9.2	2.0	2.0
7	7	TowerJazz	9.6	8.3	2.0	1.8
8	10	Fujitsu	8.5	6.5	1.7	1.4
9	8	Vanguard(世界先進)	7.4	7.9	1.5	1.7
10	9	Huahong Grace	6.5	6.7	1.3	1.4
總計			488.9	468.1	100.0	100.0

資料來源：Gartner